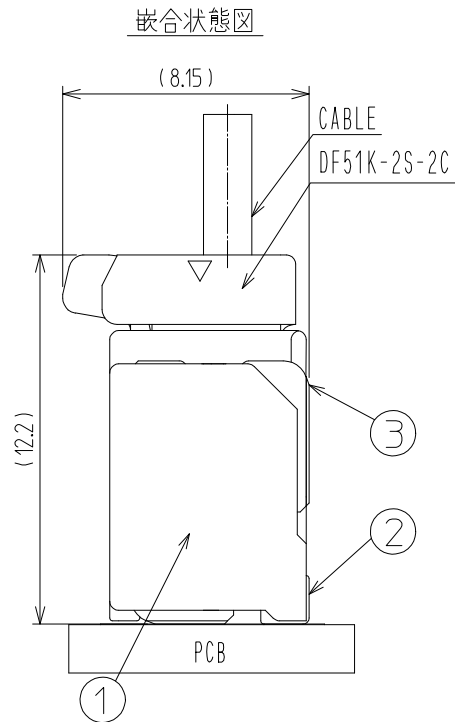
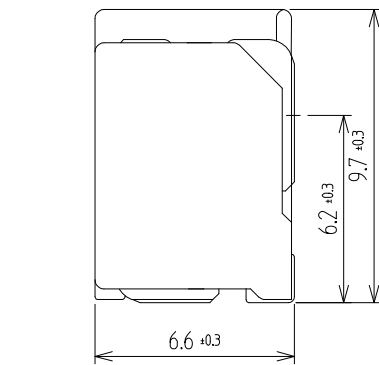
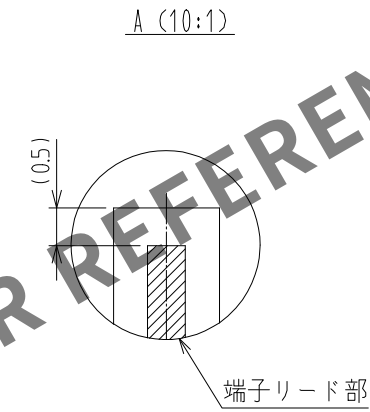
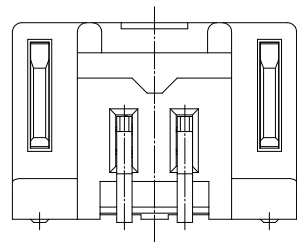
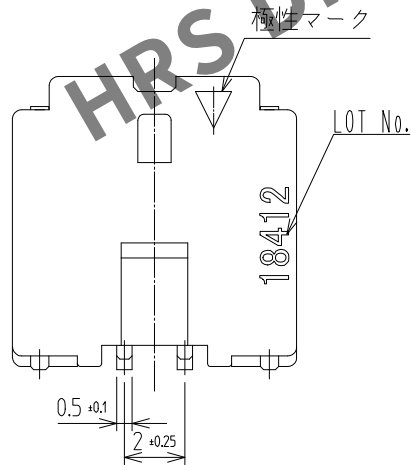
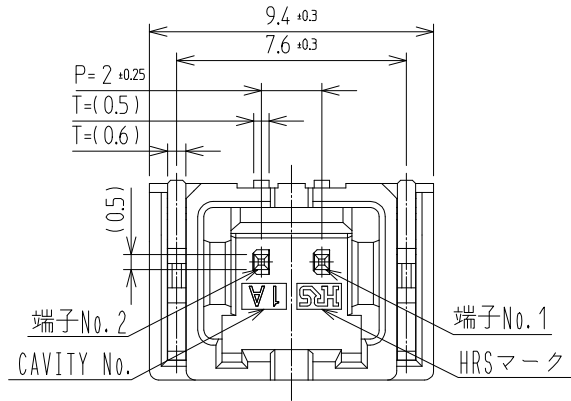
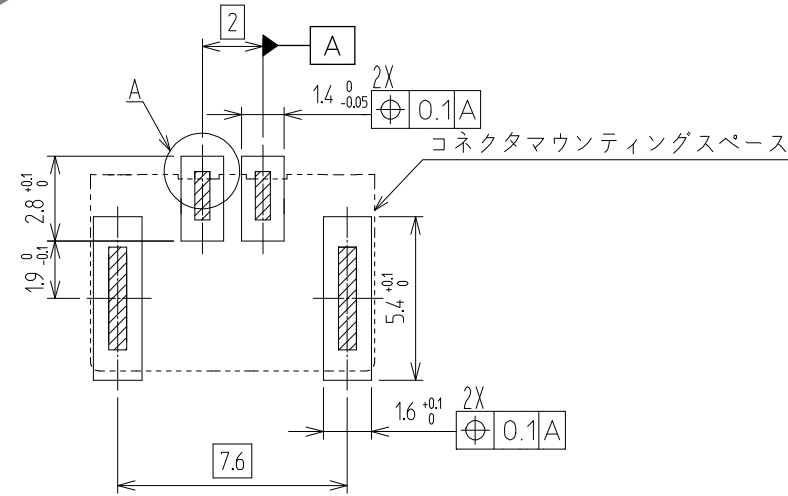


A
B
C
D
E
F



△数 COUNT	訂正事項 DISCRIPTION OF REVISIONS	擔當 B	檢圖 CHKD	年月日 DATE	△数 COUNT	訂正事項 DISCRIPTION OF REVISIONS	擔當 B	檢圖 CHKD	年月日 DATE
△				. .	△				. .
△				. .	△				. .
△				. .	△				. .

推奨PCBレイアウト(Top-View)

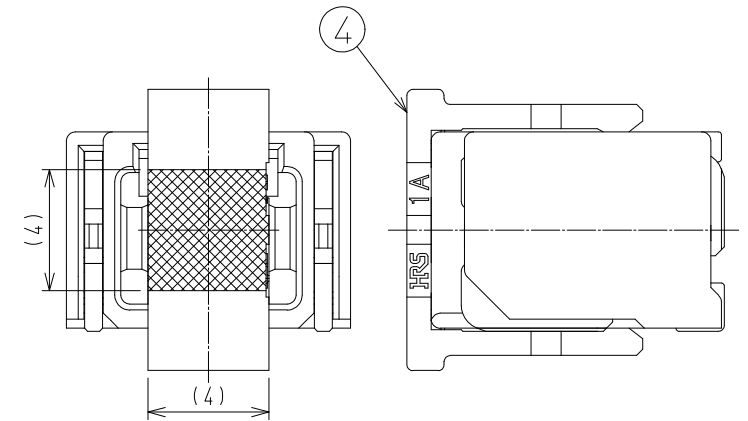


注

- はんだ付け温度：250°Cピーク、10sec以内
- 使用温度：-55°~105°C
- 使用リフロー加熱方式：エアー大気中または窒素
- リフロー回数：2回以内
- 嵌合状態図
フィメール：DF51K-2S-2C
- 端子平坦度：0.12以内
- 推奨基板厚は1.6mmとする。
- 推奨はんだ厚は0.15mmとする。
- UL(ファイルNo. E132750)認定品。
C-UL(ファイルNo. E132750)認定品。



キャップコンビネーション



4	LCP	黒	8	PS	リールボビン
3	黄銅	すずめっき：1μm MIN 下地:ニッケル 1μm MIN	7	PET	カバーテープ
2	黄銅	すずめっき：1μm MIN 下地:ニッケル 1μm MIN	6	コネクタ	DF51K-2P-2V
1	LCP	黒	5	PS	エンボスキャリアテープ
NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS
CODE NO. (OLD)			DRAWN	DESIGNED	CHECKED
			CHO 22.04.20 J.S	CHO 22.04.20 J.S	LIM 22.04.20 S.M
			APPROVED		
			LIM 22.04.20 S.M		
			RELEASED		
			ENG 2023.07.24 DEPT		
DRAWING NO. JDC3-633513			PART NO. DF51K-2P-2V (800)		
SCALE 4:1 UNITS mm			CODE NO CL 6652-0074-5-800		
HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.			1 2		

